

TGV(Through Glass Vias) ガラス基板

Glass Solution for Advanced Packaging TGV (Through Glass Vias)

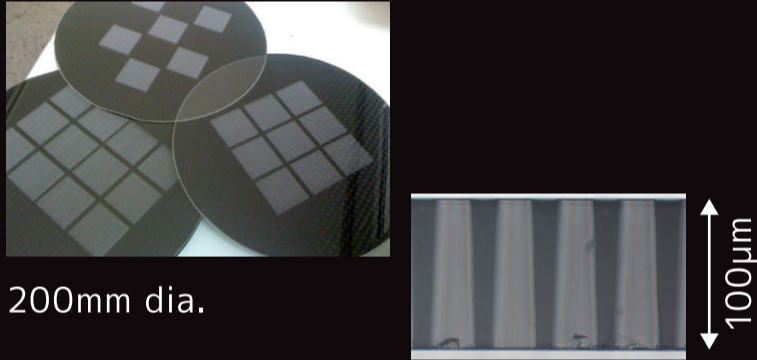
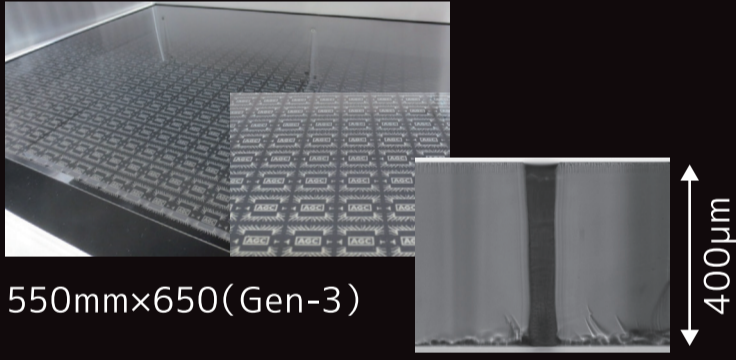
特徴 FEATURES

- ・シリコンのCTEに合わせた無アルカリガラスを使用(製品名:EN-A1)
EN-A1 Glass, CTE well matched with Si
- ・高密度、微細化対応可能な貫通孔付きガラス基板
Fine Pitch and High Dense Through Glass Vias
- ・6、8、12インチサイズのウェハから大型パネルサイズまで対応可能
Scalability, 6 to 12inch wafer, Large panel
- ・貫通孔へのメタライゼーションも可能
TGV Metallization (optional)
- ・低挿入損失、優れた電気特性
Low Insertion Loss, Excellent Electrical Performance

用途 APPLICATIONS

- ・高周波デバイス
Radio Frequency Device
- ・MEMS
Micro Electro Mechanical Systems
- ・インターポージャー
(端子ピッチ変換用中継基板)
Interposer

Performance

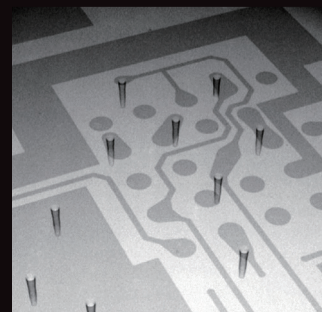
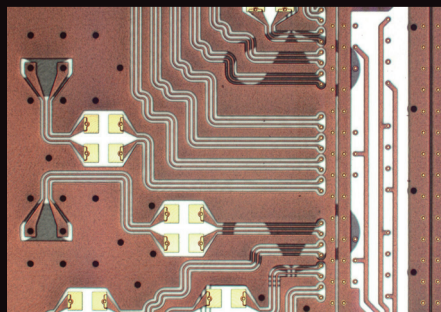
	ウェハー wafer	パネル Panel
	 <p>200mm dia. 100µm</p>	 <p>550mm x 650mm (Gen-3) 400µm</p>
サイズ Size	6inch, 8inch, 12inch	550mm x 650mm (Gen-3)
厚さ Thickness	100~500µm	100~500µm
孔径 Representative Hole Size	φ20~150µm	φ65~150µm
孔ピッチ Hole Pitch	孔径の2倍以上 Minimum 2x Hole Diameter	孔径の2倍以上 Minimum 2x Hole Diameter
メタライゼーション TGV metallization	コンフォーマル銅メッキ、全充填銅メッキ、銅ペースト充填 Cu conformal plating, Cu full-filled plating, and Cu paste fillig	コンフォーマル銅メッキ Cu conformal plating

TGV メタライゼーション例

TGV Metallization Substrate



Courtesy of Tango Systems



Courtesy of Fraunhofer IZM